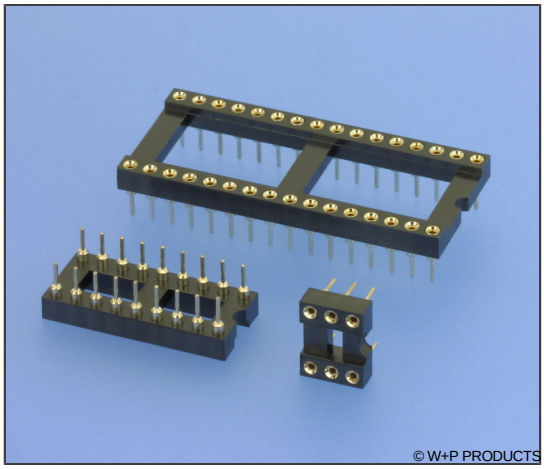
169C

IC-Fassungen RM 2,54mm - Standardversion, Bauhöhe 4,3mm

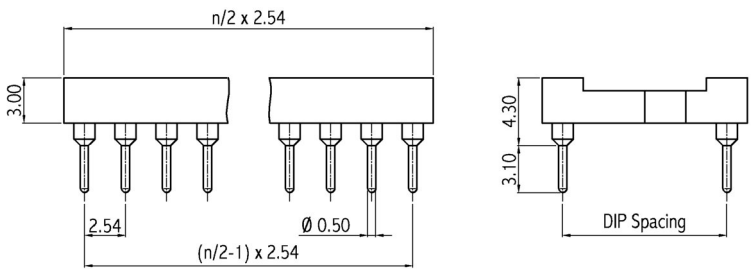
IC Sockets, 2.54mm Pitch - Standard Version, 4.3mm Profile

Technische Daten / *Technical Data*

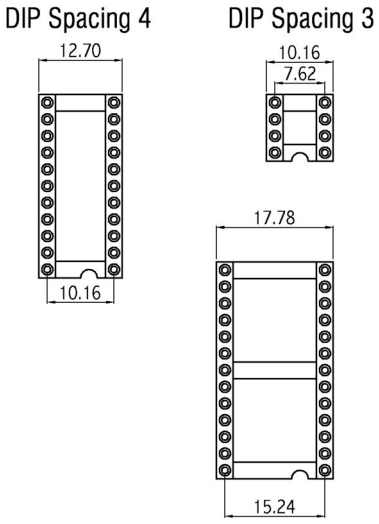
Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	*Wave soldering*



Für Rundstifte Ø 0,4 ... 0,56mm oder Vierkantstifte 0,45x0,25.
For Ø 0.4 ... 0.56mm round pins or 0.45x0.25 square pins.



IC DIP Sockets 169C



DIP Spacing 6

Series	***Contacts****	***DIP Spacing****	***Sleeve Plating***	***Clip Plating***
169C	**14**	**3**	**50**	**00**
169C IC-Fassung *IC-Socket*	**06-24 28** =====> **20-24 28 32** ===> **24 28 32 36** **40 42 48** =====>	**3** 7,62mm **4** 10,16mm **6** 15,24mm	**50** Verzinnt (Standard) *Tin plated (Standard)*	**00** Vergoldet *Gold plated*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

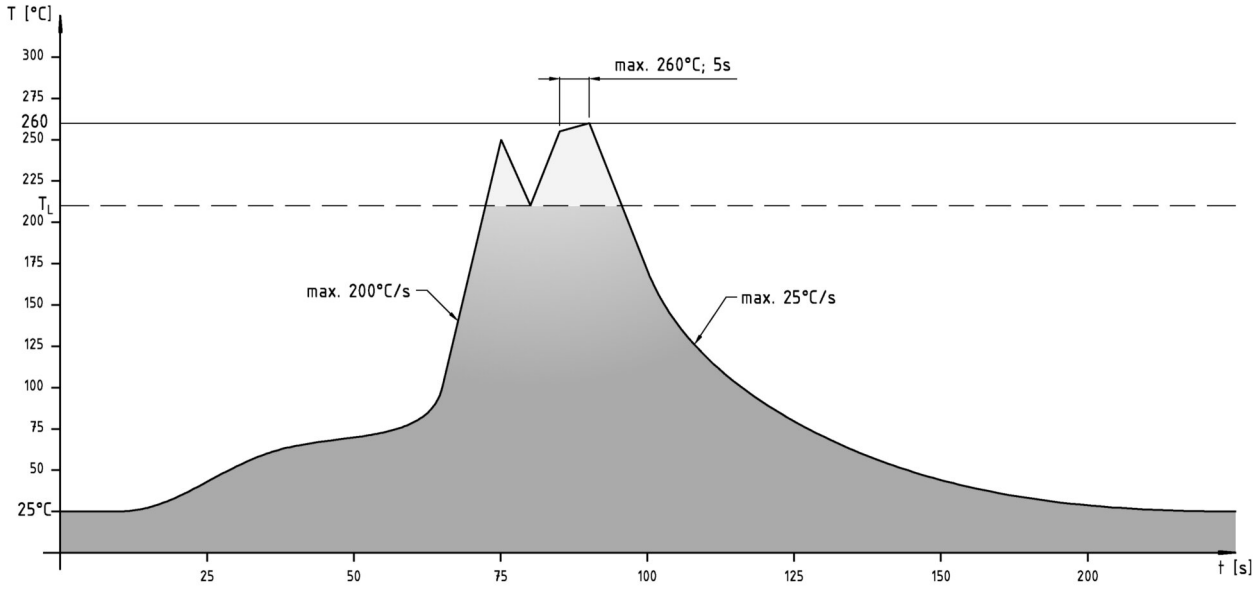
Downloaded from Arrow.com.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Downloaded from Arrow.com.